| 지식경제부 Ministry of Knowledge Economy | **보도자료** | 함께하는 공정사회! 더 큰 희망 대한민국<br>http://www.mke.go.kr |
|---|---|---|
| **2012년 5월 11일(금) 조간**부터 보도하여 주시기 바랍니다. | | |
| 자료문의 : 반도체디스플레이과 김정일 과장(2110-5680), 노승구 사무관(2110-5684) | | |

# 팹리스기업 중국 진출 위해 '한-중 정부 손 맞잡아'

– '한·중시스템IC협력연구원', 중국 선전에서 개소(5.10일) –

◇ (사례1) 스마트폰용 멀티미디어 SoC 전문업체인 A사는 그 동안 납품해 왔던 국내 스마트폰 제조사인 대기업 B사가 2년전부터 A사로부터 납품받던 제품을 자체 개발·공급함에 따라 최근 매출액이 급감하여 새로운 판로 개척 등을 위해 전전긍긍하고 있는 상황

◇ (사례2) 모바일 인터넷 디바이스용 SoC 전문업체인 C사는 고품질 및 고성능 신제품을 개발한 후, 세계 IT제품의 생산기지인 중국시장 진출을 시도하였으나, 중국시장에 대한 이해 및 네트워크 부족 등으로 초기 시장 진입에 큰 애로를 겪고 있는 상황

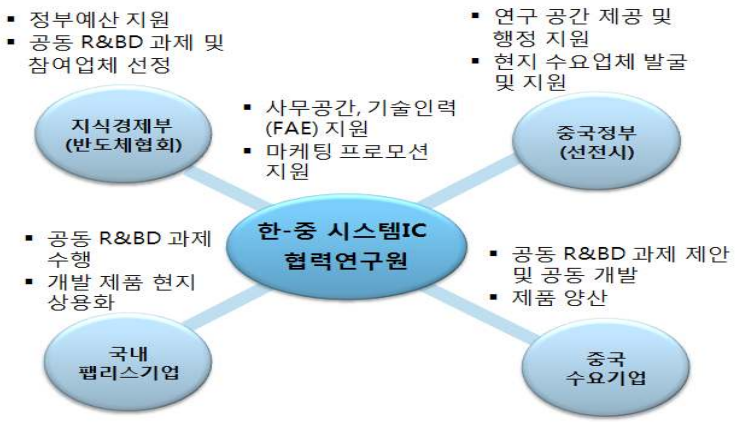
□ 새로운 성장동력 발굴에 부심하고 있는 국내 중소 팹리스업체들의 중국시장 진출에 청신호가 켜졌다.

○ 지식경제부는 세계 IT제품 생산의 메카인 중국시장에 우리 중소 팹리스기업들이 보다 원활하게 진출할 수 있도록 중국 선전시 정부, 선전시 과학기술협회, SK차이나 등과 협력하에 '12.5.10일(목) '한·중 시스템IC협력연구원'를 개설한다고 밝혔다.

○ 동 연구원은 선전시 정부가 부지 및 연구공간을 제공하고, SK차이나와 선전시 과학기술협회가 중국측 수요업체(ZTE, Huawei 등)를 알선·발굴하며, 지경부와 한국반도체협회가 공동R&D예산 및 연구 인프라 구축 지원을 담당하는 '삼각지원 체제'로 운영된다.



< 한-중 SoC협력사업 추진 체계 >




□ 동 연구원은 중국 진출에 소요되는 막대한 기술·마케팅 비용과 부족한 인력공급 및 인프라, 그리고 중국내 수요기업 및 시장에 대한 정보 부족 등 국내 팹리스 기업의 애로사항을 종합적으로 수렴하고,

○ 지난해 11월 체결된 지경부-선전시 간 MOU*('11.11월)를 바탕으로, 양국 정부의 관심과 지원하에 문을 열게 된 것이다.

* 개소식 개요

– 일자 및 장소 : '12.5.10(목), 중국 선전시 五洲호텔

– 참석 : 지경부 박일준 정보통신정책관, SK차이나 오세현 사장, 한국반도체협회 양준철 부회장, 심천시 천비아오 부시장, 조우루밍 심천시 과학기술협회 주석 등 50여명

□ 향후, 동 연구원은 국내 중소 팹리스 기업과 중국 수요기업 간 공동 연구개발, 중국시장 맞춤형 기술지원 서비스 및 중국 시장 판로 개척 지원 등의 역할을 수행할 예정인 바,

○ 현재 한-중 공동R&D과제 참여가 결정된 국내 10개 중소 팹리스 기업*(25개 신청기업중 선정)들이 중국시장에서 가시적인 성과를 창출할 수 있도록 적극 지원할 계획이다.

* 네오피델리티, 실리콘화일, 코아리버, 위더스비전, 라온텍, 아이앤씨테크놀로지, 넥스트칩, 씨앤앰마이크로, 재퍼로직, SK엠텍 등 10개 기업

## 참고1 한-중 시스템IC 협력연구원 개요

### 1 개요

○ 법인명 : 한·중시스템IC협력연구원 (深圳市韓合集成電路研究)

○ 법인 대표 : Kang Zhe (심천시)

* 자본금 : 100만 RMB(2억원), 12년예산(30억원)
* 중국 비영리기관 설립 규정에 의해 중국인이 대표를 맡게 되지만 주요 의사결정은 이사회(반도체협회 1인, SK China 3인, 심천시 3인)에서 시행

○ 소재지 : 심천시 복전구 과학관 6층

* 인원 : 연구원 사무국 및 참여기업 파견인력 약 40여명

### 2 사업내용

○ 국내 팹리스 기업의 중국 시장 진출을 위해 중국 수요기업 맞춤형 시스템IC 플랫폼 공동 기술개발

○ 양 국가의 공동연구과제 참여기업을 위한 연구공간 및 신뢰성·성능 평가 장비 등 공동연구 인프라 지원

○ 공동개발 아이템 발굴, 중국 시장 조사, 기술 교류회 등 중국 수요기업과 국내 SoC 기업간 네트워크 역할

* 고객 지원 활동을 위해 FAE(Field Application Engineer)가 상주

## 참고2 한-중 SoC 협력사업 추진 배경

◇ 국내 중소 팹리스기업은 제한된 내수 시장에서 기술우위에 있는 해외 기업들과 경쟁하고 있어 성장을 위해서는 해외시장 개척이 불가피함

* 삼성전자, LG전자 등 **국내 수요기업들은 high-end 시장을 지향**하고 있어 해외 선두기업들과 경쟁 불가피

◇ 한편, 중국 반도체 시장은 `01년이후 연 평균 25%이상 성장하고 있으며, 세계 반도체 수요의 약 45%(`11년)를 차지하는 최대 반도체 시장임

○ 성장 모멘텀 발굴에 고심하고 있는 국내 팹리스기업이 중국 수요기업과 협업하여 현지화 기술을 적용, 중국 시장에 진출하기 위한 지원이 절실



## 참고3 참여 팹리스 기업 현황

| 구분 | 업체명 | 매출액 (억원) | 종업원 (명) | 분류 | 공동 연구개발 분야 | 중국 수요기업 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 네오 피델리티 | 474 | 82 | 가전 | 중국향 FPTV용 풀디지털 오디오 앰프 IC | Skyworth, Hisense |
| 2 | 실리콘화일 | 778 | 120 | 모바일 | 고화소 CIS(CMOS Image Sensor) | ZTE, Huawei, Lenovo |
| 3 | 코아리버 | 121 | 38 | 모바일 | Application Specific MCU/ Touch Screen, Key Controller IC/Linear Motor Driver IC | ZTE, Huawei, Skyworth |
| 4 | 위더스비젼 | 52 | 19 | 모바일 | 고화소 스마트폰 카메라용 AF소형 모터 드라이버 IC | Darling, ViewFly |
| 5 | 라온텍 | 39 | 29 | 모바일 | ISDBT,TDMB,DAB,FM 통합 솔루션 기반의 모바일 TV 상용 플랫폼 | Yecon, LongHorn, Apical |
| 6 | 아이앤씨테크놀로지 | 348 | 89 | 모바일 | China Mobile 표준 CMMB(China Multimedia Mobile Broadcasting) SoC 및 모듈 개발 | Simcom, ZTE, INFOSpace |
| 7 | 넥스트칩 | 458 | 142 | 보완 | CCTV와 DVR용 영상솔루션(HD-Mux) | TVT, Hanbang, Visiondigi |
| 8 | 씨앤앰마이크로 | 5.3 | 21 | 가전 | B-CAS가 내장된 일본 및 동남아 Full-seg 방송 A/V 수신 Solution | Skyworth, UMEC, TCL |
| 9 | 제퍼로직 | 10 | 11 | 가전 | 고속 인터페이스 대면적 TFT-LCD드라이버 IC | TRULY, BOE, TCL, ZTE |
| 10 | SK엠텍 | 33 | 52 | 가전 | 보급형 스토리지 솔루션 개발 | ZTE, Huawei, Lenovo |